

仕 様 書

1. 件 名 多層超伝導集積回路チップの製作（ADP670）
2. 納 入 場 所 国立大学法人横浜国立大学 電子情報工学棟 107 室
3. 完 納 期 限 令和 8 年 1 月 30 日（金）
4. 納 入 物 品

品名	数量
ADP670 チップ	1 式

※基本仕様については別添「詳細仕様書」を参照し、その他記載のない事項については
本学担当教員と打合せの上、調整を行うこと。

5. そ の 他
 - (1) 納入等に係る必要な経費は本契約に含むこと。
 - (2) 物品は本学が指定した場所（室）に納入後、本学担当教職員の確認を受けること。
 - (3) 物品の納入に際し、他の物品又は建物等に損傷を与えた場合は、直ちに本学担当教職員に連絡し無償にて補修するものとする。
 - (4) 納入日程は、本学受領担当者と打ち合わせのうえ、期限の範囲内で決定すること。原則、納入日時は平日 9：00～17：00 の間とする。
 - (5) その他詳細については、本学担当教職員に確認すること。